SK하이닉스, 전 직원에 '위기극복 격려금' 120만원 지급한다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014106117?sid=102

(서울=연합뉴스) 장하나 기자 = 반도체 업황 악화로 상반기에만 6조원이 넘는 적자를 낸 SK하이닉스가 전 직원에게 120만원의 '위기극복 격려금'을 지급할 것으로 알려졌다.  
  
  
  
SK하이닉스 본사[연합뉴스 자료사진]1일 업계에 따르면 SK하이닉스 노사는 최근 '2023년 임금협상 잠정합의안'에 위기극복 명목의 격려금 지급을 추가하기로 합의한 것으로 전해졌다. 앞서 SK하이닉스 노사는 올해 연봉 인상률을 총 4.5%로 하되, 분기 영업이익이 흑자로 전환하는 시점에 1월부터의 임금 인상분을 소급해 지급하는 방안에 잠정 합의했다. 이에 대해 민주노총 산하 기술사무직 노조는 지난달 투표를 거쳐 합의안에 동의했으나, 한국노총 소속의 이천·청주공장 전임직 노조는 잠정 합의안을 부결시키고 사측과 추가 협상을 진행해 왔다. SK하이닉스는 복수노조 체제를 채택하고 있다. 오는 3일 전임직 노조의 투표에서 격려금 지급을 포함한 합의안이 최종 통과되면 SK하이닉스의 올해 임금 협상도 모두 마무리된다. 이 경우 임원을 제외한 전 직원이 오는 10일께 120만원을 받게 될 것으로 알려졌다. 한편 SK하이닉스의 올해 2분기 영업손실은 2조8천821억원이다. 앞서 1분기에도 3조4천23억원의 영업손실을 냈다. 다만 HBM3와 DDR5 등 프리미엄 제품 판매가 늘어나며 2분기 매출은 1분기 대비 44% 늘고 영업손실은 15% 감소했다. hanajjang@yna.co.kr

SK하이닉스, 전 직원에 120만원 격려금

https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000062150?sid=101

임금 협상안에 격려금 지급 포함…노조 투표 후 최종 확정  
  
  
  
올 2분기에도 영업 적자를 피해 가지 못한 SK하이닉스가 전 직원에게 120만원의 '위기극복 격려금'을 지급할 것으로 전해졌다. ⓒ연합뉴스SK하이닉스가 전 직원에게 120만원의 '위기극복 격려금'을 지급하기로 했다. 실적 부진으로 상반기에 지급되지 않은 성과급을 대신해 직원들의 사기를 진작하고자 결정한 것으로 보인다. 2일 관련 업계에 따르면, SK하이닉스 노사 측은 최근 '2023년 임금협상 잠정 합의안'에 위기 극복 차원의 격려금 지급안을 포함하기로 합의한 것으로 알려졌다. 이르면 오는 10일 임원을 제외한 전 직원에게 지급할 것으로 보인다. 오는 3일 노조 투표에서 격려금 지급을 포함한 합의안이 최종 확정되면, SK하이닉스는 올해 임금 협상을 모두 완료하게 된다.앞서 SK하이닉스 노사는 올해 연봉 인상률을 총 4.5%로 책정하되, 분기 영업이익이 흑자로 돌아서는 시점에 1월부터 누적된 임금 인상분을 소급 지급하는 방안에 잠정 합의했다.민주노총 산하 기술사무직 노동조합(노조)는 지난달 투표를 거쳐 합의안에 동의했지만, 한국노총 소속의 이천·청주 공장 전임직 노조는 잠정 합의안을 부결시키고, 회사 측과 추가 협상을 벌여 왔다. SK하이닉스 내에서는 두 개의 노조가 활동하고 있다.SK하이닉스는 그간 매해 상반기와 하반기에 한 차례씩 기본급의 100%까지 달하는 성과급을 지급해 왔다. 성과급 지급률은 반기별 경영 계획이나 생산량 목표치 등에 따라 결정되는데, 올 상반기에는 회사가 6조원에 가까운 누적 적자를 내면서 성과급이 지급되지 않았다.SK하이닉스는 올해 2분기 영업손실 2조8821억원을 기록했다. 앞서 1분기에도 3조4023억원의 영업손실을 냈다. 다만 HBM3와 DDR5 등 프리미엄(고부가) 제품 판매가 늘어나며, 2분기 매출은 1분기와 비교해 44% 늘고 영업손실은 15% 하락했다.

대세는 HBM···삼성전자·SK하이닉스, 기싸움 '치열'

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000762998?sid=101

하반기부터 5세대 제품 경쟁···적극 투자 통해 생산능력도 확대인공지능(AI) 챗봇 챗GPT 열풍이 불면서 고대역폭메모리(HBM) 가치가 치솟고 있다. 메모리 시장을 주도하는 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM의 기술 경쟁도 점입가경이다.2일 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스가 새로운 세대의 HBM을 지속해서 내놓고 있다.HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 제품이다.  
  
  
  
SK하이닉스가 개발한 12단 적층 HBM3 [사진=SK하이닉스 ]HBM은 좁은 면적에 여러 D램의 데이터 연결 통로를 촘촘하게 밀집시키는 방식으로 생산된다. 4차선 도로를 짓는 대신 4개 층을 가진 1차선 도로를 만드는 셈이다.메모리반도체 업체들은 그동안 그래픽처리장치(GPU)가 요구하는 고대역폭 메모리를 GDDR(Graphics Double Data Rate)이란 이름으로 꾸준히 공급해 왔는데, 그래픽 처리를 능가할 정도로 높은 메모리 용량이 요구되면서 HBM의 활용도가 높아졌다.SK하이닉스는 한 발 빠른 대응으로 HBM 시장을 주도하고 있다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 상위 3개 HBM 공급업체 점유율은 SK하이닉스(50%), 삼성전자(40%), 마이크론(10%) 순으로 차지했다.SK하이닉스는 HBM 4세대 제품인 HBM3를 2021년 세계 최초로 개발했으며, 지난 4월에는 세계 최초로 D램 단품 칩 12개를 수직 적층해 현존 최고 용량인 24기가바이트(GB)를 구현한 HBM3 신제품을 개발하는 데 성공했다.특히 SK하이닉스는 챗GPT용 그래픽처리장치(GPU)를 만드는 엔비디아에 HBM을 공급하고 있다. 챗GPT로 엔비디아에 이어 SK하이닉스까지 주목받는 모양새다.내년 상반기에는 5세대 제품인 HBM3E 양산에 돌입하고, 2026년 6세대 제품인 HBM4를 양산할 계획이다.SK하이닉스는 내년 투자 우선 순위에 HBM을 두고 있으며, HBM 물량도 2배 확대할 계획이다.SK하이닉스 관계자는 "내년 투자 우선순위에 HBM을 두고 있다"며 "물량을 2배 늘릴 것"이라고 말했다.삼성전자는 점유율을 넓히기 위해 SK하이닉스보다 갈 길이 바쁘다. 삼성전자는 업계 최고 6.4Gbps의 성능과 초저전력을 기반으로 하는 HBM3 16GB와 12단 24GB 제품의 양산 준비를 완료했다. 4분기부터 HBM3와 5세대인 HBM3P를 출하하고 내년부터 6세대 HBM도 생산할 계획이다.삼성전자 관계자는 "올해는 전년 대비 2배 수준인 10억Gb 중반을 넘어서는 고객 수요를 이미 확보했다"며 "하반기 추가 수주에 대비해 생산성 확대를 위한 공급 역량을 확대하고 있다"고 말했다.이어 "내년 HBM 생산능력(캐파)은 증설 투자를 통해 올해 2배 이상이 될 것"이라고 덧붙였다.트렌드포스에 따르면 올해 전 세계 HBM 수요는 2억9천만 GB로 작년보다 60% 가까이 증가하고, 내년에는 30% 더 성장할 것으로 예상된다.다만 일각에선 빅테크 업체들이 올해 AI 서비스에 대한 강력한 투자에 나서면서, 내년 2분기 이후엔 투자 휴지기가 올 수 있다는 관측이 나오고 있다. HBM 열풍이 일시적일 수 있다는 우려다.이와 관련해 업계 관계자는 "고객사가 시설투자(캐펙스)를 준비하고 있는 얘기를 들어보면 내년 HBM 성장세에 대한 우려는 없다"며 "성장을 걱정하는 건 시기상조라 본다"고 말했다.곽민정 현대차증권 연구원은 "딥러닝 구현을 위한 AI GPU와 관련된 HBM 수요가 앞으로 기대된다"며 "올해를 기점으로 미국과 중국 빅테크 업체들의 챗GPT 투자 확대에 따른 HBM 수요가 큰 폭으로 늘 것"이라고 강조했다.

SK하이닉스, 전 직원에 '위기극복 격려금' 지급

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001116980?sid=101

반도체 업황 악화로 상반기에만 6조원이 넘는 적자를 낸 SK하이닉스가 전 직원에게 120만원의 '위기극복 격려금'을 지급할 예정이다.1일 업계에 따르면 SK하이닉스 노사는 최근 '2023년 임금협상 잠정합의안'에 위기극복 명목의 격려금 지급을 추가하기로 합의했다.앞서 SK하이닉스 노사는 올해 연봉 인상률을 총 4.5%로 하되, 분기 영업이익이 흑자로 전환하는 시점에 1월부터의 임금 인상분을 소급해 지급하는 방안에 잠정 합의했다.이에 민주노총 산하 기술사무직 노조는 지난달 투표를 거쳐 합의안에 동의했으나, 한국노총 소속의 이천·청주공장 전임직 노조는 잠정 합의안을 부결시키고 사측과 추가 협상을 진행해 왔다.오는 3일 전임직 노조의 투표에서 격려금 지급을 포함한 합의안이 최종 통과되면 SK하이닉스의 올해 임금 협상도 모두 마무리된다. 이 경우 임원을 제외한 전 직원이 오는 10일께 120만원을 받게 될 것으로 알려졌다.SK하이닉스는 올해 1분기 3조4천23억원, 2분기 2조8천821억원의 영업손실을 기록했다.(사진=연합뉴스)

HBM 둘러싼 삼성전자의 SK하이닉스 추격전 '눈길'

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002735939?sid=101

수요 상승에 따라 치열해진 HBM 선두경쟁실적 발표 컨콜에서도 '선두 업체' 강조지난해 이어 올해 시장 점유율 변화 여부 주목  
  
  
  
SK하이닉스가 개발한 12단 적층HBM3. HBM3현존 최고 용량인24GB(기가바이트)가 구현됐다.ⓒSK하이닉스[데일리안 = 임채현 기자] 생성형 AI에 필수적인 HBM(고대역폭메모리) 수요가 빠르게 증가하고 있다. 시장 점유율 각 1~2위를 차지하고 있는 SK하이닉스와 삼성전자 모두 최근 진행된 실적발표 컨퍼런스콜에서 자사의 기술 우위를 강조했는데, 특히 HBM 후발주자인 삼성전자가 이와 관련한 향후 로드맵과 투자 계획을 상세히 밝혀 이목을 끌고 있다.1일 업계에 따르면, 삼성전자는 최근 HBM 시장에 본격적으로 뛰어들고 있다. 재고가 쌓인 DDR4 감산과 더불어 DDR5 등의 D램을 중심으로 출하량을 늘리고 있는데 특히 그중에서도 고부가가치가 큰 HBM이 하반기 반도체 실적 개선의 키포인트가 될 것으로 예상되고 있기 때문이다.실제로 지난달 27일 삼성전자의 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서도 HBM은 투자자들의 집중적인 관심을 받았다. 최근 생성형 AI 시장이 고공 성장함에 따라 방대한 데이터를 원활하게 처리할 수 있는 고성능 메모리 수요가 폭발적으로 증가하는 분위기가 반영된 것으로 풀이되고 있다.HBM은 D램 여러 개를 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 제품이다. 생성형 AI 서버에 탑재되는 HBM 가격은 기존 메모리보다 6배 이상 높기에 단순히 높은 수요 문제를 떠나 실제 수익성 측면에서도 그 가치가 높게 평가된다.삼성전자는 이날 실적발표 이후 진행된 컨퍼런스콜에서 '업계 최고 수준의 성능 및 용량'이라는 표현을 여러 차례 쏟아냈다. 삼성전자는 "당사는 HBM 시장의 선두 업체로 HBM2를 주요 고객사에 독점 공급했고, HBM2E도 제품 사업을 원활히 진행 중"이라며 "4세대인 HBM3에서도 업계 최고 수준의 성능과 용량으로 고객과 협의 진행 중"이라고 강조했다.이는 전날 SK하이닉스의 실적발표를 의식한 듯한 발언이다. 실제로 SK하이닉스와 삼성전자는 투자자들로부터 HBM 기술 경쟁력에 대한 질의를 연이어 받았다. SK하이닉스의 컨콜에서 주로 시장 선점에 대한 질문이 주를 이뤘다면, 삼성전자 컨콜에서는 시장 확대 전략이나 차별화 등에 대한 질문이 주로 나왔다.이에 삼성전자는 "HBM 시장 내 메이저 공급업체로서 지속적인 투자를 바탕으로 업계 최고 HBM 생산 능력을 유지하고 있다"며 "이를 기반으로 올해는 전년 대비 2배 수준인 10억 기가비트 중반을 넘어서는 고객 수요를 이미 확보했고, 2024년 HBM 생산능력을 올해 대비 최소 2배 이상 확보 중”이라고 밝혔다.삼성전자는 지난 2018년 2세대 HBM2를 '아쿠아볼트'라는 브랜드명으로 양산한 이후 2020년에는 3세대인 HBM2E '플래시볼트'를 출시, 시장에 공급하고 있다. 이어 4세대 HBM3는 '아이스볼트'라는 이름으로 올해 하반기부터 대량 생산에 들어갈 예정이다.앞서 경계현 삼성전자 DS부문 대표이사 사장도 자사의 HBM 기술력과 관련해 언급한 바 있다. 지난달 6일 경 사장은 임직원과 진행한 '위톡'에서 "최근 삼성전자 HBM3 제품이 고객사로부터 우수하다는 평가를 받고 있다"며 "HBM3, HBM3P가 내년에는 DS부문 이익 증가에 기여하게 될 것"이라고 전했다.다만 아직까지는 SK하이닉스가 앞선 상황이다. SK하이닉스는 내년 상반기 5세대 제품은 HBM3E 양산에 돌입한다. 삼성전자 역시 올 하반기 5세대에 해당하는 HBM3P를 출하할 예정이다. 출시는 양산에 앞서 시제품 공개 등의 형태로 진행되기에 5세대 부분에서는 SK하이닉스가 한발 빠른 것으로 관측되고 있다.시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 상위 3개 HBM 공급업체 점유율은 SK하이닉스(50%), 삼성전자(40%), 마이크론(10%) 순으로 차지했다. 올해의 경우 SK하이닉스의 점유율이 소폭 증가하고 삼성전자는 40%를 밑돌 것으로 전망되고 있다.

SK하이닉스, 전직원에 120만원 위기극복 격려금

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005050940?sid=101

지난해 4·4분기부터 적자에 빠진 SK하이닉스가 전 직원에게 120만원의 격려금을 지급한다. 1일 업계에 따르면 SK하이닉스 노조는 이날 설명회를 열고 직원들에게 올해 '위기극복 격려금' 명목으로 120만원을 지급하기로 했다고 밝혔다. 앞서 지난 6월 기술전임직 노조가 '2023년 임금협상 잠정합의안'에 동의하지 않기로 하면서 노사협의가 난항을 겪자 추가 논의를 통해 위기극복 성격의 격려금 지급을 추가 합의한 것으로 알려졌다. 이번 위기극복 격려금은 SK하이닉스가 매년 상반기와 하반기에 지급한 성과급인 생산성 격려금(PI)과는 성격이 다른 것으로 전해진다. SK하이닉스는 매년 상반기와 하반기에 최대 기본급 100%까지 지급하는 PI를 지급했다. 영업흑자 달성시 지급되는 PI는 반기별로 세운 경영 계획이나 생산량 목표치 등을 달성한 정도에 따라 지급률이 결정된다. 업계에서는 올 상반기 연이은 실적부진으로 사실상 PI 지급이 어려운 상황이다. 다만, 사측이 직원들의 사기 진작을 위해 PI와 별도로 정액 방식의 특별 격려금 지급을 결정한 것으로 파악된다. 앞서 SK하이닉스는 1·4분기와 2·4분기 각각 3조4023억원과 2조8821억원의 적자를 기록했다. 한편, 삼성전자도 지난달 7일 임직원들에게 '목표달성 장려금(TAI)'을 각 사업 부문별로 지급했다. 이 가운데 반도체 부문(DS)은 파운드리, 메모리, 시스템LSI 등 사업부에 기본급의 25%를 상반기 성과급으로 책정했다.

추가감산 돌입한 삼성·SK하이닉스, 낸드 손실 줄이기 ‘총력전’

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000921300?sid=105

삼성전자, 낸드 주력 라인도 가동률 조정2년여만에 웨이퍼 투입량 최저치낸드 ‘보릿고개’ 한동안 지속된다  
  
  
  
삼성전자 시안 반도체공장. /삼성전자 제공 삼성전자, SK하이닉스, 키옥시아 등 주요 메모리 기업들이 급격한 가격 하락으로 팔수록 적자를 보고 있는 낸드플래시 생산량을 최소한으로 운영하며 손실 줄이기에 나섰다. 앞서 삼성전자는 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 낸드 추가 감산을 선언한 바 있으며, 키옥시아와 마이크론, SK하이닉스 등도 일제히 생산량을 줄여나가는 추세다.1일 업계에 따르면 삼성전자는 최대 낸드 생산라인인 평택, 시안 공장에서의 가동률을 조정하고 있다. 그동안 평택, 시안을 제외한 비주력 라인에서만 생산량을 줄였던 것과 달리 이제는 최대 생산기지에서의 웨이퍼(반도체 원판) 투입량도 조정하는 중이다. D램에 비해 여전히 높은 수준으로 형성돼 있는 재고 처리를 위해서는 주력 라인에서의 생산량도 줄여야 한다는 경영진의 판단이 작용한 것으로 보인다.업계에 따르면 삼성전자는 올해 3분기부터 화성 16라인의 낸드 웨이퍼 투입을 중단한 상황이며, 최대 낸드 생산지인 평택과 시안 공장 역시 월평균 투입량을 22~23만장에서 20만장 수준으로 하향조정할 것으로 알려졌다. 이는 2년여 만에 최저 수준이다. 이에 따라 연간 낸드 생산량 전망도 내년에는 10% 줄어들 전망이다.낸드는 현재 메모리 반도체 기업들 실적 악화의 주범으로 꼽힌다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 메모리카드·USB향 낸드플래시 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC)의 고정거래가격은 올해 들어 3월(5.12%)과 4월(2.93%) 2차례나 떨어졌다. 낸드 시장에서 삼성전자(34.0%), SK하이닉스(솔리다임 포함 15.35%)가 압도적 지위를 차지하고 있는 만큼 가격 하락의 타격이 크다. SK하이닉스의 2분기 낸드 재고평가손실은 5000억원 수준이다.반도체업계 관계자는 “현재 낸드 시장에서 제조기업들은 가격 협상력이 거의 전무할 정도로 불리한 지위를 차지하고 있다”며 “주요 낸드 기업들 모두 현재 쌓인 재고만으로 1년 영업이 가능할 정도로 과잉 생산 기조가 이어져 왔고 수요는 좀처럼 살아나지 않고 있기 때문에 판매가격이 거의 생산원가에 근접한 수준”이라고 설명했다.결국 추가 감산을 통해 메모리 재고를 낮춤으로써 고객사들의 수요가 살아나야 낸드 매출 회복을 기대할 수 있다는 평가다. 실제 삼성전자, SK하이닉스는 지난 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 추가 감산을 시사한 바 있기도 하다.SK하이닉스는 지난해 4분기(10~12월)부터 감산을 진행 중인 가운데, 하반기에도 낸드 생산을 5~10%가량 추가 감산하기로 결정했고 삼성전자 역시 낸드 위주의 생산 하향 조정폭을 확대한다고 밝힌 바 있다. 이에 앞서 마이크론도 낸드플래시 웨이퍼 투입량을 기존 25%에서 30%까지 더 줄였다고 밝혔다. 일본의 키옥시아도 이미 작년 4분기부터 시작한 30% 감산을 올해부터 50%로 확대한 것으로 알려졌다.당장 시장 수요 회복을 기대하기도 힘든 상황이어서 한동안 낸드 ‘보릿고개’는 지속될 전망이다. 특히 주요 고객사인 스마트폰 등 모바일 업체는 여전히 재고 비축에 소극적인 상황이다. 서버 업체들도 AI 관련 투자를 제외하면 재고 조정을 지속하면서, 전반적인 구매 수요 회복세가 확인되지 않고 있다. 박찬동 SK하이닉스 부사장도 2분기 실적발표 콘퍼런스콜을 통해 “낸드는 상대적으로 AI향 서버 수요 업사이드에 대한 영향이 D램 대비 제한적”이라고 밝혔다.시장조사업체 트렌드포스는 3분도 낸드 평균판매단가(ASP)가 전 분기 대비 3~8% 하락할 것으로 전망했다. 전 분기(10~15%) 대비 낙폭은 축소될 전망이다. 다만 일반적으로 하반기는 IT 업계 성수기이지만, 여전히 시중 재고가 많아 낸드 수요 업체들이 구매에 신중한 상황이라고 트렌드포스는 전했다.

삼성전자·SK하이닉스, 7조 원 손실에도 웃는다…하반기 반등 기대감↑

https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000230425?sid=105

2분기 삼성전자 DS부문 4조 원대·SK하이닉스 2조 원대 손실하반기 HBM 중심으로 수요 회복…"낸드 등 감산 이어갈 것"  
  
  
  
삼성전자 DS부문과 SK하이닉스가 올해 2분기에만 합산 7조 원이 넘는 적자를 냈다. 양사는 올해 상반기까지 이어진 반도체 불황이 하반기부터 개선될 것이라 기대하고 있다. /삼성전자 홈페이지 캡처올해 상반기까지 이어진 '반도체 한파'에 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문과 SK하이닉스가 총 7조 원이 넘는 영업손실을 냈다. 그러나 삼성전자와 SK하이닉스는 오히려 자신감을 드러내고 있다. 반도체 업황의 반등 신호가 뚜렷한 만큼, HBM 등 고부가가치 제품 위주로 하반기 실적 개선에 나선다는 구상이다.31일 업계에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스는 올해 2분기에도 반도체 부문에서 적자를 이어갔다.삼성전자 DS부문은 매출 14조7300억 원, 영업손실 4조3600억 원을 기록했다. 1분기(4조5800억 원)보다 적자 폭이 줄기는 했지만, 여전히 막대한 금액이다. 삼성전자 DS부문의 상반기 적자는 8조9400억 원으로 집계됐다.SK하이닉스는 2분기 매출 7조3059억 원, 영업손실 2조8821억 원을 각각 기록했다. SK하이닉스는 지난해 4분기 분기 적자를 기록한 뒤 3개 분기 연속 적자를 기록하고 있다. SK하이닉스 역시 지난 1분기 적자 대비(3조4023억 원) 2분기 적자 폭을 줄인 것에 의의를 두고 있다.반도체 업계는 지난해 하반기부터 이어진 업황 악화로 인해 실적이 크게 악화했다. 러시아-우크라이나 전쟁 등의 매크로 이슈와 글로벌 경기침체가 이어지며 IT 관련 수요가 크게 줄어든 상황에 반도체 공급 과잉 상황에 빠지며 가격이 큰 폭으로 하락했기 때문이다. 또한 재고율도 치솟으며 기업들의 부담을 가중시켰다.  
  
  
  
삼성전자 DS부문은 올해 2분기 4조 3600억 원의 적자를 냈다. /더팩트DB업계는 혹독했던 반도체 불황의 끝이 보인다고 판단하고 있다.메흐로트라 CEO는 지난달 28일(현지시각) 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "마이크론은 메모리 반도체 매출이 저점을 통과했다고 믿으며, 업계 공급과 수요의 균형이 점차 회복되며 마진이 개선될 것으로 예상한다"고 밝혔다.최태원 SK그룹 겸 대한상공회의소 회장도 지난 12일 대한상의 출입기자단 간담회에서 "(반도체 업황은) 올라갈 일만 남았다"며 "반도체가 밑으로 떨어진 데서 더 나빠지지 않고 업사이클로 올라가는 흐름에 있다. (반등시점은) 2~3년 뒤가 아니라, 6개월~1년 뒤 정도로 보인다"고 기대감을 드러냈다.실제로 반도체 가격 하락 폭은 줄어들고 있고, 재고율도 개선 흐름을 탔다.통계청에 따르면, 올해 1월 반도체 재고율은 265.7%로 집계됐다. 전년 동기 대비 39.5% 늘었다. 이는 외환위기가 본격화되던 지난 1997년 3월 이후 25년 10개월 만에 가장 높은 수준이다.반면, 통계청은 6월 산업활동동향에서 지난달 반도체 생산이 전월보다 3.6% 증가했다고 밝혔다. 반도체 생산은 4개월 연속 증가세를 기록했다. 반도체 재고도 지난 5월 대비 12.3% 줄었다. 수출 등 출하는 41.1% 급증했다. 6월 반도체 수출액은 89억 달러를 기록해 연중 최대 규모를 기록했다.시장조사업체 D램익스체인지의 통계를 살펴보면, D램 가격이 4월 전 달 대비 19.9% 하락한 데 이어, 5월 3.46%, 6월 2.86% 하락을 기록하는 등 낙폭이 개선되고 있다.  
  
  
  
SK하이닉스는 지난해 4분기부터 올해 2분기까지 영업 적자를 냈다. /더팩트DB삼성전자와 SK하이닉스는 반도체 반등 시점에 맞춰 HBM 등 인공지능(AI) 연산에 특화된 고성능 반도체를 중심으로 실적 개선에 나선다는 구상이다.삼성전자는 "DS부문은 DDR5, LPDDR5x, HBM3 등 고부가 제품 판매와 신규 수주를 확대할 방침"이라며 "인프라·R&D, 패키징에 투자를 지속하고 게이트 올 어라운드(GAA) 공정 완성도 향상 등으로 중장기 경쟁력을 강화할 계획"이라고 밝혔다.SK하이닉스도 AI용 메모리인 HBM3, 고성능 D램인 DDR5, LPDDR5와 176단 낸드 기반 SSD를 중심으로 판매를 꾸준히 늘릴 예정이다. 또한 올해 10나노급 5세대(1b) D램과 238단 낸드의 초기 양산 수율·품질을 향상시켜 다가올 업턴 때 양산 비중을 빠르게 늘릴 계획이다.삼성전자와 SK하이닉스는 반등 효과를 더욱 공고히 하기 위해 일부 제품군에 대한 감산 조치도 이어간다.김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난 27일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "생산량 하향 조정으로 D램, 낸드 플래시 모두 5월 정점을 기록한 이후 빠른 속도로 재고가 줄고 있다"며 "재고 정상화를 가속화하기 위해 D램, 낸드플래시 모두 제품별 선별적인 추가 생산 조정을 하고 있다"고 밝혔다. 이어 "낸드 위주 생산 하향 조정폭을 더 크게 적용할 것"이라고 예고했다.김우현 SK하이닉스 최고재무책임자(CFO)는 지난 26일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "낸드플래시는 재고 수준이 D램보다 높고 수익성이 저조한 상황이기 때문에 현재 5∼10% 수준의 추가 감산을 결정했다"고 밝혔다.발로 뛰는 더팩트는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.▶카카오톡: '더팩트제보' 검색▶이메일: jebo@tf.co.kr▶뉴스 홈페이지: http://talk.tf.co.kr/bbs/report/write

“엔비디아發 최대 수혜주는 HBM 독점 공급하는 SK하이닉스”

https://n.news.naver.com/mnews/article/037/0000032868?sid=101

이형수 HSL Partners 대표 “삼성전자, 테슬라 차세대 칩 수주해야 TSMC 추격 발판”인공지능(AI) 열풍이 국내 반도체 시장에도 거세게 불고 있다. AI용 특화 메모리인 고대역폭메모리(HBM) 시장을 차지하기 위한 SK하이닉스와 삼성전자의 경쟁이 본격화되고 있는 것이다. 4세대 HBM3를 선점한 SK하이닉스는 여세를 몰아 HBM 공정 전환에 초점을 맞춘 설비투자에 나서겠다고 밝혔다. 한발 뒤진 삼성전자는 올해 안에 HBM3를 양산하겠다고 발표했다.AI 시대를 맞아 국내 반도체 산업은 어떻게 진화할까. 7월 25일 반도체 투자 전문가인 이형수 HSL Partners 대표를 만나 메모리 시장을 전망하고, HBM 수혜 기업을 분석했다. 이 대표는 ‘전자신문’에서 IT(정보기술) 전문기자로 10년 동안 재직한 뒤 산업분석 전문 사이트 KIPOST에서 이사로 활동했으며, 반도체 투자 사이클을 알려주는 책 ‘바로 써먹는 최강의 반도체 투자’를 냈다. 현재는 유튜브 채널 ‘IT의 신’과 다양한 언론매체를 통해 반도체 및 IT 산업 분석과 투자 전망 등을 제시하고 있다.  
  
  
  
이형수 HSL Partners 대표. [조영철 기자]SK하이닉스 HBM3 독점AI 열풍에 반도체 트렌드도 급변하고 있는데.“최근 반도체 산업은 예전처럼 단순 하락과 반등 사이클로만 분석해선 안 된다. 반도체는 PC(개인형 컴퓨터) 시대를 지나 모바일, 서버, 클라우드, 그리고 AI 혁명까지 왔다. 현재까지 AI 혁명은 서버와 클라우드에서만 일어나고 있는데, 향후 AI 시대가 본격적으로 열리면 누구나 디바이스를 통해 AI를 사용할 수 있을 것이다. 그럼 반도체 산업에도 큰 변화가 올 것이 자명하다.”국내에서 AI 열풍을 체감할 수 있는 반도체 분야가 있나.“엔비디아 GPU(그래픽처리장치)와 함께 사용되는 메모리 반도체 HBM이다. HBM은 D램 여러 개를 수직으로 쌓아 대량의 데이터를 한꺼번에 처리하는 첨단 메모리 반도체다. 1세대 HBM, 2세대 HBM2, 3세대 HBM2E를 거쳐 현재 SK하이닉스가 독점적으로 4세대 HBM3를 양산하고 있다.”HBM의 핵심 기술은 무엇인가.“기존 D램이 단층 주택이라면 HBM은 D램을 아파트처럼 쌓아올린 구조다. 적층한 D램에 미세한 구멍을 뚫어 상단과 하단을 수직으로 관통하는 전극을 연결하는 첨단 패키징 기술인 실리콘관통전극(TVS)이 핵심이다(그림 참조). HBM3는 D램을 12층까지 쌓는데, 이때 전체 높이가 GPU보다 높지 않아야 한다. 따라서 웨이퍼를 종이처럼 얇게 만든다. 이 얇은 웨이퍼에 구멍 뚫기가 생각보다 쉽지 않다.”HBM은 SK하이닉스가 삼성전자보다 한발 앞서가고 있는데.“과거에는 삼성전자가 메모리 반도체 기술을 리드하고 SK하이닉스가 따라가는 구조였는데, HBM3 부문에서는 SK하이닉스가 삼성을 앞질렀다. 한국 메모리 반도체 역사상 처음이다. 현재 삼성전자는 2세대인 HBM2와 3세대인 HBM2E를 양산하고 있다. 하반기 안에 삼성전자도 HBM3를 양산한다고 한다.”한국이 HBM 시장 90% 장악  
  
  
  
TSV 원리. [SK하이닉스 제공]삼성은 왜 HBM 시장을 놓쳤나.“HBM은 2008년 AMD가 처음 개발했다. 당시 게임용 GPU에 HBM을 많이 사용할 줄 알았는데, 그렇지 못했다. 이후에도 삼성전자는 계속 HBM을 연구개발했지만 2019년까지도 시장 상황이 달라지지 않자 HBM 팀을 해체하고, 그래픽 D램인 GDDR에 집중했다. 그런데 지난해 11월 오픈AI가 챗GPT를 출시하면서 AI 혁명이 시작되자 HBM 시장이 확 열렸다. 삼성전자는 AI 혁명이 이렇게 시작될지 몰랐던 것이다. 사실 미국 빅테크 기업도 마찬가지다.”AI 시대가 예상보다 빠르게 시작되면서 미국 빅테크 기업들도 적잖게 당황하고 있는데.“IT 분야에서는 마이너 기술이 갑자기 주류가 되는 경우가 많다. AI의 바탕인 딥러닝은 1987년에 나온 기술인데, 오랜 시간 주목받지 못했다. 그런데 2012년부터 기술 특이점을 넘기 시작하더니 딥러닝 기반 기술이 다른 기술들을 압도하기 시작했다. 딥러닝화되면서 하드웨어가 CPU(중앙처리장치)에서 GPU 기반으로 바뀌었고, 오픈AI의 챗GPT를 기점으로 다시 한 번 기술 특이점을 넘어섰다. 하지만 미국 빅테크 기업들도 자체적으로 AI가 준비돼 있지 않았다. 그래서 엔비디아 GPU를 최대한 많이 쓰게 된 것이다. 일단 GPU를 많이 붙이면 컴퓨팅 성능이 높아지기 때문이다.”AI 시대에 가장 중요한 것은 반도체라는 말인가.“AI는 딥러닝을 통해 성능이 느닷없이 향상된다. 이를 창발성이라고 한다. AI 창발성을 위해서는 컴퓨팅 파워, 빅데이터, 알고리즘 등 세 가지 요소가 중요하다. 빅데이터는 약 5조 개가 있으면 충분하다. 그런데 컴퓨팅 파워는 GPU를 많이 쓸수록 계속 좋아진다. AI용 GPU를 만드는 기업이 엔비디아고, 엔비디아 AI용 GPU에 들어가는 메모리 반도체가 HBM이다. 엔비디아 AI용 GPU 수요가 폭발적으로 증가하니 HBM도 성장할 수밖에 없다. 운 좋게 한국이 전 세계 HBM 시장의 90%를 장악하고 있다.”메모리 반도체 시대가 다시 열리는 것 같은데.“1990년대 PC 시대에는 인텔 CPU와 함께 메모리 반도체 수요가 많았다. 모바일 시대에도 AP(애플리케이션 프로세서)와 메모리가 같이 성장했다. 서버 클라우드 시대도 마찬가지였다. 그런데 코로나19 시대에 파운드리(반도체 위탁생산)는 슈퍼 사이클이 일어난 반면, 메모리 반도체는 계속 정체돼 있었다. 드디어 AI 시대를 맞아 메모리 반도체가 반등 사이클을 탈 것으로 보인다.”국내 반도체 기업 중 수혜 기업을 꼽는다면.“AI 반도체 최대 수혜 기업은 전 세계적으로 AI용 GPU의 90%를 생산하는 엔비디아다. 나머지 10%는 AMD 등이 만드는데, 이는 양산용이 아니다. 실제 양산용 AI 칩은 엔비디아의 A100과 H100밖에 없다. 따라서 주가도 엔비디아와 관련된 기업만 올랐다. 한국, 대만, 일본 등 전 세계적으로도 비슷하게 엔비디아와 친한 업체들만 주가가 상승했다. 국내는 HBM3를 양산하는 SK하이닉스와 HBM3 장비업체 한미반도체다.”한미반도체를 엔비디아 수혜 기업으로 꼽는 이유는 무엇인가.“HBM에서 핵심은 TSV 기술과 칩끼리 붙이는 본딩이다. 한미반도체가 TSV 공정에 필수인 TC본딩을 독점하고 있다.”HBM은 어떻게 진화할까.“HBM 성능을 향상하려면 D램 층수를 높이고 미세 홀을 더 많이 뚫으면 된다. 4세대 HBM3는 D램을 12층까지 쌓는데, 층수를 더 높이기가 쉽지 않다. 열 압착으로 칩을 붙일 때 사용하는 마이크로솔더볼이 25㎛ 정도까지 가까워지면 녹아서 붙기 때문이다. 그래서 솔더볼 없이 붙이는 하이브리드 본딩으로 가는 추세다. SK하이닉스는 하이브리드 본딩으로 가더라도 열 압착 방식을 함께 쓸 것으로 보이고, 삼성전자는 HBM4부터 하이브리드 본딩을 도입하겠다고 한다.”메모리 반도체도 시스템 반도체처럼 궁극적으로 ASIC (Application-Specific Integrated Circuit·주문형 반도체)화 될까.“하이엔드 메모리는 HBM 같은 주문형이 될 것으로 보인다. 최근 애플이 공개한 비전 프로에는 SK하이닉스의 주문형 메모리가 들어간다. 향후 출시되는 AI 디바이스, 자율주행차, UAM(도심항공교통), 로봇에도 주문형 메모리가 탑재될 수밖에 없다.”TSMC IP, 삼성의 3배 수준  
  
  
  
[조영철 기자]삼성전자 파운드리가 테슬라의 차세대 차량용 칩 수주에 성공했다고 알려지면서 시장에서는 TSMC와 격차를 좁힐 수 있을지에 주목하고 있다. 과연 삼성이 TSMC를 넘어설 수 있을까.“모바일 시대에는 애플 AP를 누가 생산하느냐에 따라 파운드리 기술 수준이 달라졌다. TSMC의 파운드리 기술이 삼성전자를 앞서기 시작한 것은 애플 칩을 100% 생산하면서다. 파운드리는 칩 설계를 잘하는 고객사와 함께 문제를 해결하다 보면 기술이 좋아지고 IP(설계자산)도 쌓이게 된다. 현재 TSMC는 2만여 개의 IP를 소유하고 있고, 삼성전자는 7000개 정도다. IP는 경쟁사가 사용할 수 없기 때문에 격차가 벌어지면서 기술력을 따라잡기 힘들었다. 앞으로는 모빌리티 시대다. 누가 테슬라를 잡느냐에 따라 파운드리 기술 수준이 완전히 달라질 수 있다. 만약 삼성이 테슬라의 차세대 칩을 생산하면서 IP 수를 늘려간다면 TSMC와 격차를 줄일 수 있으리라 본다.”차세대 차량용 반도체에서 핵심 기술은 무엇인가.“코로나19 사태 이후 차량 반도체의 쇼티지(부족) 문제가 발생했지만, 테슬라는 예외였다. 테슬라에 들어가는 반도체는 수준이 다르기 때문이다. 내연차에 필요한 칩은 200~300개, 전기차는 1000개, 자율주행차는 2000개다. 내연차에 장착되는 칩은 유럽 인피니티나 일본 르네상스 같은 업체들이 만드는 40~50㎚ 수준의 칩이 분산형으로 들어간다. 반면 테슬라 전기차에는 모바일 AP와 비슷한 고성능 칩이 중앙집중형으로 들어간다. 앞으로 차세대 차량에는 테슬라처럼 중앙집중형 고성능 칩이 사용될 것으로 보인다.”삼성전자 파운드리가 테슬라의 차세대 차량용 칩을 생산할 때 수혜를 받을 기업은 어디인가.“삼성전자가 테슬라의 첨단 차량용 칩을 생산한다면 엄청난 서플라이체인이 생기게 된다. 일단 삼성전자의 파운드리 비즈니스가 잘될수록 시스템 반도체를 설계하는 칩리스 기업들의 생태계가 좋아진다. 파운드리에서 칩을 설계할 때 15~20%는 새로 설계하고 나머지는 기존 IP를 쓰는데, 이때 IP를 판매하는 업체들도 수혜를 받을 수 있다. 국내 상장사 중에는 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지가 대표적이다. 설계도를 파운드리와 연결하는 분야도 커질 수 있다. 반도체 설계는 프로그래밍과 비슷한데, 이 반도체 설계 도면으로 레이아웃하는 디자인솔루션파트너(DSP) 업체도 좋아질 것으로 보인다. DSP에는 가온칩스, 코아시아, 에이디테크놀로지 같은 회사가 있다. 무엇보다 후공정 시장이 커질 것으로 보인다. 후공정 전문 조립·테스트 아웃소싱(OSAT) 업체는 대만 ASE와 미국 앰코테크놀로지가 대표적인데, 국내도 이런 OSAT 업체가 많아져야 한다.”한국 산업이 한 단계 점프할 기회로 보인다.“대한민국 국민소득이 1만 달러가 될 때 중화학공업이 산업을 이끌었고, 2만 달러가 넘어갈 때는 차화정(자동차·화학·정유)이 있었다. 현재 국민소득 3만 달러를 만든 것은 반도체 덕분이다. 이제 4만 달러로 가야 하는데, 이때 제일 중요한 부분이 파운드리 시장을 잡는 것이라고 생각한다. 만약 삼성이 파운드리에서 TSMC를 잡는다면 국민소득 5만 달러까지도 갈 수 있다고 본다.”향후 반도체가 국내 산업을 주도할 것이라 보는 건가.“맞다. 반도체 형태가 바뀌고 있다. 기존 컴퓨터는 시스템 반도체 따로, 메모리 반도체 따로였는데 AI는 사람의 뇌를 모방한다. 반도체도 사람의 뇌처럼 프로세스와 저장을 함께하는 형태로 변화되고 있기 때문에 메모리 산업에서 혁신이 일어날 수밖에 없다. 메모리 반도체와 시스템 반도체가 융합적으로 성장한다는 얘기다. 종합반도체 기업인 삼성전자가 유리하다.”8만전자는 시간문제지금까지는 삼성전자가 AI 시대에 제대로 대처하지 못한 모습인데.“맞다. 삼성전자 파운드리는 지난해까지만 해도 위기였다. TSMC보다 수주도 떨어졌는데 공정 기술까지 뒤처지면서 생산 수율이 안 나왔다. 그래서 제일 중요한 고객사인 퀄컴도 삼성전자의 모바일 AP 스냅드래곤 생산 수율이 35%밖에 안 나오자 TSMC로 갔다. 그런데 최근 삼성전자가 TSMC의 생산 수율을 따라잡기 시작했다. 또한 7월 인사에서 이례적으로D램 개발실장과 파운드리 개발실장 2명을 교체하며 변화된 모습을 보였다. 경계현 삼성전자 사장은 원래 외부 발언을 잘안 하는 편인데, 공개적으로 HBM3P 양산 계획을 말하기도 했다. 삼성전자가 확실히 달라지고 있는 것 같다.”삼성전자 주가가 언제 ‘8만전자’가 될지도 관심사다.“8만전자는 시간문제다. 다만 6만 원에 사 8만 원에 팔 사람은 별로 없지 않나. 최소한 2배는 되길 바라는데, 삼성전자가 전고점을 뚫고 10만전자를 돌파하려면 파운드리에서 확실한 성과를 내야 한다. 엔비디아나 AMD 칩을 의미 있게 생산해야 하고, 차세대 디바이스나 자율주행차 AP에서도 성과가 있어야 한다. 삼성 조직문화는 하드 코어다. 방향성이 정해지고 리더가 푸시하면 언제나 성과를 냈다. 그런 삼성의 DNA를 믿는다.”  
  
  
  
\*유튜브와 포털에서 각각 ‘매거진동아’와 ‘투벤저스’를 검색해 팔로잉하시면 기사 외에도 동영상 등 다채로운 투자 정보를 만나보실 수 있습니다.

中보다 무서운 美의 반도체 굴기 삼성 ‘2위’ 뺏기고 SK하이닉스는 ‘3위’로?

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005167219?sid=004

중국을 견제하기 위해 ‘반도체’를 무기로 꺼내든 미국의 굴기가 우리 기업들을 위협하는 수준으로 확대되고 있다.반도체 위탁생산 사업에 재진출한 미국 인텔은 삼성전자를 제치고 시장 2위에 등극할 것으로 전망된다. 인텔은 최근 파운드리 경쟁력 강화를 위해 세부 사업 구조를 개편하고 ‘내부 파운드리’ 모델을 본격적으로 추진하기로 했다. 내년 1분기부터 자체 생산하는 중앙처리장치(CPU) 등을 자사 파운드리 수익으로 집계한다. 데이비드 진스너 인텔 CFO(수석 부사장)는 최근 투자자 대상 웨비나에서 이 같은 계획을 발표했다.인텔은 7나노미터(㎚·10억분의 1m) 공정의 벽에 부딪혀, 지난 2018년 파운드리 시장 철수를 결정했다. 하지만 팻 겔싱어 최고경영자(CEO) 취임 이후 반도체 제국의 영광을 재건하겠다며, 2021년 시장 재진출을 선언했다. 인텔은 반도체 사업 부문을 팹리스(반도체 설계)와 파운드리로 분리하겠다는 계획이다.이렇게 되면 내부적으로 반도체 생산 주문을 파운드리 사업부가 수주받아 생산에 나서는 방식이 되고, 자사 칩 생산 실적이 파운드리 매출로도 잡히게 된다. 데이비드 CFO는 “2024년에는 내부 물량을 기준으로 200억달러 이상의 제조 매출을 기록해 파운드리 2위 사업자가 될 것으로 예상한다”고 밝혔다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 지난해 파운드리 사업에서 208억달러의 매출을 기록했다. 이를 감안하면 인텔의 2위 사업자 선언이 실현될 가능성은 충분히 높다.인텔, 삼성 잡으려 ARM과 협력 강화이 같은 매출 집계 방식은 실제로 이미 그 효과가 입증됐다. 현 2위인 삼성전자의 파운드리사업부도 삼성전자 제품을 별도의 고객 매출로 잡기 시작하면서 매출 규모가 급속도로 확대됐다. 인텔도 내년부터 단숨에 글로벌 파운드리 빅3 업체로 몸집을 키우면서 세를 과시하고 외부적으로 홍보 효과를 누릴 것으로 기대하고 있다.하지만 인텔의 2위 선언이라는 야심찬 대대적 선언이 무색하게도 투자자들의 반응은 냉담했다. 발표 다음날 뉴욕 증시에서 인텔의 주가는 오히려 전거래일보다 6% 급락한 32.90달러를 기록했다.발표 내용이 투자자들이 기대했던 내용이 아니었기 때문이다. 인텔이 파운드리 재진입을 선언한 뒤 투자자들이 전망한 것은 신사업이라고 할 수 있는 외부 물량 대량 수주였다. 한데 인텔이 내부 회계 방식 변화로 ‘2위’를 하겠다는 전략을 밝히자 이를 ‘꼼수’로 받아들인 것이다. 로이터통신은 “인텔의 발표는 역설적이게도 투자자들에게 인텔의 현재 제조 규모가 소규모이며 당분간 이 수준이 유지될 것임을 알려주는 것”이라고 평가하기도 했다.텔은 즉각 수습에 나섰다. 인텔은 “외부 수주 물량 기준으로도 2030년까지 2위 사업자가 되겠다는 목표에는 변함이 없다”고 강조했다.  
  
  
  
 올라프 숄츠 독일 총리와 팻 겔싱어 인텔 CEO는 지난 6월 인텔이 독일 정부의 재정지원으로 독일 마그데부르크 반도체공장에 300억유로를 투자하는 내용의 협약에 서명했다. <사진 연합뉴스>하지만 인텔의 이 같은 전략을 단순‘꼼수’로만 치부하기는 어렵다고 보고 있다. 실제로 인텔은 본인들의 목표를 이루기 위해서 막대한 투자를 진행하고 있기 때문이다. 인텔은 지난 6월 18일 250억달러를 들여 이스라엘 남부 키르얏 갓에 반도체 공장을 짓기로 했다. 지난 16일에도 46억달러(약 6조원)를 들여 폴란드 브로츠와프 지역에 반도체 패키징 및 테스트 같은 후공정 라인을 지을 계획이라고 밝히기도 했다. 독일 마그데부르크(170억유로), 아일랜드 레익슬립(120억유로)에도 첨단 반도체 공장을 건설할 예정이다. 실제로 지난 4월 인텔은 ARM과 함께 인텔의 18A(옹스트롬) 공정을 활용한 모바일용 SoC(시스템온칩)를 생산한다고 밝히기도 했다. 인텔의 18A 공정은 1.8나노(㎚)에 해당한다. 인텔 측은 “이번 협력은 우선적으로 모바일 SoC 설계에 중점을 두고 있지만 향후 자동차, 사물인터넷(IoT), 데이터센터, 항공우주산업 등으로 확장할 수 있다”고 설명했다. 모바일 AP(애플리케이션 프로세서) 시장의 90% 이상을 장악하고 있는 ARM과의 협력을 계기로 인텔이 파운드리 시장에서 빠르게 안착할 수 있다는 평가도 나온다. 블룸버그는 “겔싱어는 인텔 프로세서의 경쟁력을 높여주는 신기술을 보유한 ARM에서 자리를 잡음으로써, 개방성을 수용하겠다는 의지를 보여줄 수 있다”고 전했다.SK하이닉스, 마이크론에 점유율 밀려삼성전자와 함께 국내 반도체 업계의 자존심으로 여겨졌던 SK삼성전자와 함께 국내 반도체 업계의 자존심으로 여겨졌던 SK하이닉스는 미국 마이크론에 글로벌 시장 점유율 2위 자리를 내주고 9년 만에 3위로 밀려났다.대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 마이크론의 올해 1분기 D램 매출은 27억2200만달러를 기록했다. 전분기(28억2900만달러)에 비해 3.8% 줄었다.같은 기간 SK하이닉스 매출은 23억1200만달러로, 33억8600만달러를 기록한 지난 분기에 비해 31.7% 급감했다. SK하이닉스는 1분기 출하량과 평균판매단가(ASP)가 모두 15%이상 하락해 가장 가파른 하락세를 보였다.지난해 4분기 D램 시장에서 SK하이닉스의 점유율(매출 기준)은 27.6%로 마이크론(23.1%)에 앞선 2위 자리를 유지했지만, 올해 1분기 시장 점유율은 마이크론 28.2%, SK하이닉스23.9%로 2위와 3위의 순위가 바뀌었다.트렌드포스는 “글로벌 톱3 메모리반도체 기업 가운데 SK하이닉스의 메모리반도체 D램 출하량 감소폭과 ASP 하락폭이 가장 컸다”며 “반면 마이크론의 출하량은 전분기 대비 늘었다”고 설명했다.삼성전자와 SK하이닉스는 미국 기업들의 추격을 가만히 바라보고 있지 않겠다는 의지를 내비쳤다.  
  
  
  
 삼성전자와 현대차그룹은 현대차 차량에 프리미엄 인포테인먼트(IVI)용 프로세서인 ‘엑시노스 오토 V920’을 탑재한다고 밝혔다.삼성전자는 ARM과 손잡은 인텔처럼 ‘K연합’을 꾸렸다. 삼성전자는 현대자동차와 차량용 인포테인먼트(IVI) 분야에서 손을 맞잡았다. 디스플레이, 카메라 모듈, 사운드 시스템에 이어 반도체까지 삼성과 현대차 간 협력 범위가 확대되고 있다. 삼성전자는 최근 현대차 차량에 프리미엄 IVI용 프로세서인 ‘엑시노스 오토 V920’을 공급한다고 밝혔다. 두 회사는 2025년 제품 수급을 목표로 본격적인 협력에 들어갈 계획이다. ‘엑시노스 오토 V920’은 삼성전자의 프리미엄 IVI용 프로세서다. 운전자에게 실시간 운행 정보는 물론 고화질 멀티 미디어 재생, 고사양 게임 구동과 같은 엔터테인먼트 요소를 지원한다.특히 이번 제품은 영국 반도체 설계 전문기업 ARM의 최신 전장용 CPU 10개가 탑재돼 기존 제품보다 성능이 약 1.7배 향상됐다. 한국의 전자산업과 자동차산업을 대표하는 삼성전자와 현대차는 이번 협업으로 ‘비즈니스 파트너’ 관계를 확실히 다졌다는 평가가 나온다. 두 회사 간 ‘미래차 협업’이 본격화되고 있다는 얘기다. 일본 전자기업 소니와 자동차기업 혼다가 미래차 개발을 위한 협업을 진행 중인 것처럼 삼성전자와 현대차 간 협업 방향에 대한 산업계 안팎의 기대감도 커지고 있다. 피재걸 삼성전자 시스템LSI사업부 부사장은 “삼성전자는 이번 협력을 통해 IVI용 프로세서 시장에서 리더십을 공고히 다질 수 있게 됐다”고 설명했다. 제품 공급과 관련해 특별한 대외적인 발표가 없었던 삼성 다른 관계사의 사례와 달리, 이번 삼성전자의 ‘엑시노스 오토 V920’ 공급 소식은 공식적인 발표로 공개됐다. 그만큼 미래차를 겨냥한 삼성과 현대차의 협력관계가 ‘공식화’되는 신호라는 해석이다. ‘엑시노스 오토 V920’은 최신 그래픽 기술 기반의 차세대 그래픽처리장치(GPU)를 탑재, 그래픽 처리 성능이 이전보다 최대 2배 빨라졌다. 이를 통해 사용자는 고사양의 게임을 비롯해 더욱 실감 나는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 경험할 수 있다는 게 삼성전자 측 설명이다. 이와 함께 최신 연산코어를 적용해 신경망처리장치(NPU) 성능도 약 2.7배 강화했다. 운전자 음성을 인식하고 상태를 감지하는 운전자 모니터링 기능은 물론, 주변을 빠르게 파악해 사용자에게 더욱안전한 주행 환경을 제공한다. 차량용 시스템의 안전 기준인 ‘에이실(ASIL)-B’를 지원해 차량 운행 중에 발생할 수 있는 시스템 오작동을 방지하는 등 높은 안정성을 제공한다.삼성, 차량용 반도체에 주목삼성전자는 급성장하는 차량용 반도체 시장에 주목하고 있다. 시장조사기관인 IHS에 따르면 지난해 말 기준 세계 차량용 반도체 시장 규모는 680억달러를 넘어섰고, 2029년 말에는 이보다 2배가 넘는 1430억달러에 달할 것으로 예상된다. 차량에 탑재되는 반도체 종류도 더 다양해져 2029년까지 7년간 연평균 11% 성장세가 예상된다는 게 IHS의 예측이다.SK하이닉스는 또 다른 대어 애플과 손을 잡았다. SK하이닉스의 D램이 애플의 차세대 혼합현실(MR) 헤드셋 ‘비전 프로’에 탑재될 예정이다.10일 업계에 따르면 SK하이닉스는 최근 애플이 출시를 예고한 비전 프로에 들어갈 맞춤형 D램을 공급하는 것으로 알려졌다. 이 D램은 애플이 비전 프로를 위해 자체 개발한 새로운 칩 ‘R1’과 연동한다. R1 칩은 카메라 12개, 센서 5개, 마이크 6개가 입력한 정보를 처리해 콘텐츠가 이용자 눈앞에서 실시간으로 보이는 것처럼 느껴지게 한다. 비전 프로용 D램 공급과 관련해 SK하이닉스 측은 “고객사 정보는 확인해줄 수 없다”고 밝혔다. 비전 프로는 스키 고글처럼 머리에 착용하는 공간형 컴퓨터다. 컴퓨터나 아이폰에서 해왔던 컴퓨팅 기능을 3차원(3D) 공간에서 구현할 수 있는 기기다. 새로운 운영체제인 비전OS에 이용자가 눈과 손, 음성을 통해 기기를 조작할 수 있도록 카메라와 센서를 갖췄다.애플은 지난 6월 초 열린 연례 세계개발자회의(WWDC)에서 비전 프로를 처음 공개하고, 내년 초 출시를 예고한 바 있다.매일경제 산업부 오찬종 기자

삼성전자·SK하이닉스 실적 악화에 지자체 살림도 '휘청'

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005294413?sid=102

반도체 실적 악화로 지자체 세수 급감市 재정 20~30% 차지…긴축 불가피반도체 경기 침체에 일선 지방자치단체의 살림살이가 직격탄을 맞았다. 삼성전자, SK하이닉스의 실적이 악화하면서 이들 기업이 내는 세금이 연간 세수의 30%를 차지하는 수원·화성·이천·평택 등 이른바 수도권 남부 반도체 벨트는 긴축 재정에 나서는 모습이다. 특히 세수 감소는 도로·철도 등 사회간접자본(SOC) 투자 위축을 낳을 것으로 우려된다.지자체로 번진 삼성·하이닉스 실적 쇼크 "코로나19가 끝나니 반도체 쇼크가 오네요." 삼성전자 반도체 공장이 위치한 수도권의 한 지자체 세정과 담당자의 푸념이다.과연 반도체 쇼크는 일선 지자체 재정에 어느 정도 영향을 미쳤을까. 삼성전자 본사가 있는 수원시의 경우를 보자. 삼성전자가 수원시에 내는 세금은 두 가지다. 법인 지방소득세(소득세)와 재산세다. 부동산 등에 부과하는 재산세는 공시가격 등락에 따라 변동이 있지만, 진폭은 크지 않다. 실적 악화로 가장 크게 타격을 받는 부분은 바로 소득세다.  
  
  
  
삼성전자가 지난해 수원시에 낸 소득세는 2141억원. 이 금액이 올해는 1517억원으로 쪼그라들었다. 29.1%나 감소한 금액이다. 그나마 지난해 상반기까지는 반도체 경기가 나았기 때문에 선방했다는 게 수원시 관계자의 전언이다. 문제는 내년이다. 수원시 관계자는 "지금 같은 추세라면 내년에는 사실상 삼성전자에서 기대할 소득세는 거의 없다고 봐야 할 것 같다"고 내다봤다. 수원시의 경우 전체 세수에서 삼성전자가 차지하는 비중이 27% 정도다.SK하이닉스 본사가 위치한 이천시도 비상이 걸리긴 마찬가지다. 정확하지는 않지만 지난해 이천시가 SK하이닉스로부터 거둬들인 소득세는 2000여 억원. 올해는 이 금액이 1400억원대로 추락했다. 이천시 역시 내년 SK하이닉스의 소득세 납부액이 거의 없을 것으로 우려하고 있기는 마찬가지다. SK하이닉스가 이천시 세수에서 차지하는 비중은 25~30% 선에 달한다.삼성전자 캠퍼스가 있는 평택·화성도 동병상련을 겪고 있다. 평택시는 지난해 1470억이었던 삼성전자 소득세가 올해는 1393억으로 줄어든 데 이어 내년에는 500억~600억원 선으로 급감할 것으로 우려한다. 화성시의 경우 구체적인 금액은 밝히지 않고 있지만 역시 삼성전자 실적 악화에 따른 세수 감소는 피할 수 없을 전망이다. 삼성·하이닉스 실적 얼마나 안 좋길래지난해 1·2분기 각각 77조원대의 매출과 14조원대의 영업익을 기록했던 삼성전자의 실적이 급격한 하향곡선을 보인 것은 그해 3분기부터다. 매출은 76조7817억원으로 전 분기 대비 0.5% 정도 줄었지만, 영업익은 10조8520억원으로 10조원 선에 겨우 턱걸이했다.   
  
  
  
급기야 4분기에는 매출 70조4646억원, 영업익 4조3061억원으로 여건이 급격히 악화한 데 이어 올해 들어서는 매출 60조원대마저 위협받고 있다. 1분기와 2분기 영업익은 각각 전년 동기 대비 95%나 줄어든 6402억원, 6685억원에 그쳤다. SK하이닉스의 실적 쇼크는 더 심각하다. 지난해 2분기 매출 13조8110억원, 영업익 4조1972억원이었지만 그해 3분기 매출은 10조9826억원, 영업익은 1조6556억원으로 급감했다. 심지어 지난해 4분기에는 1조8984억원의 영업손실을 기록한 데 이어 올해 1분기에는 손실 폭이 3조4203억원으로 확대됐다. 2분기에는 2조8821억원(잠정)으로 적자 폭을 다소나마 줄인 것이 위안거리다.지자체, 마른 수건 쥐어짜 보지만…SOC 직격탄 우려지자체 전체 세수의 20~30%를 차지하는 두 기업의 실적 악화로 내년도 각 지자체의 예산은 시계 제로 상태다.아직 구체적 예산안이 마련되진 않았지만, 지자체 예산 담당 부서들은 마른 수건을 쥐어짜는 심정으로 예산안을 짜야 할 것 같다는 분위기다. 평택시 기획예산과 관계자는 "일단 고정경비 절감 등 세수 감소에 따른 대응책을 마련하고는 있지만 쉽지 않은 문제"라고 말했다.세수가 줄어든 만큼 지자체로서는 지출을 줄일 수밖에 없다. 사실상 지자체 살림살이 전반에 대한 고강도 긴축이 예고된 셈이다.특히 SOC 투자는 세수 감소의 직격탄을 맞을 것으로 우려된다. 일단 세수가 줄더라도 주민 생활과 직결되는 복지 등 현금성 지출을 섣불리 줄이기는 힘들다. 따라서 몇 년에 걸쳐 예산이 투입되는 도로·철도 등 SOC 예산을 줄이는 것이 가장 현실적인 대안이라는 게 일선 지자체들의 공통적인 목소리다.한 지자체 기획예산 담당자는 "도로, 철도 등 계속 사업의 경우 공사 유지관리에 필요한 최소한의 예산을 배정할 수밖에 없을 것 같다"고 말했다. 이렇게 되면 SOC 사업은 공기 지연, 착공 연기나 규모 축소는 불가피해지는 셈이다.그렇다고 뾰족한 수가 있는 것도 아니다. 결국 반도체 경기의 빠른 회복을 기대할 수밖에 없는 실정이다.이천시 관계자는 "한때 반도체 경기 호황 때는 하이닉스의 소득세 수입만 4000억원에 달할 정도였다"며 "일선 지자체 입장에서는 기업이 살아야 지자체도 산다는 말을 실감하고 있는 중"이라고 말했다.

SK하이닉스, 상반기 6.3조 적자에도…HBM '날갯짓'(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011996099?sid=101

SK하이닉스 2분기 2.9조 적자…전년 동기 대비 적자 전환전분기비 적자폭 15.3% 감소…시장 전망치 웃돌아"프리미엄 제품 판매 늘어…D램 판매가 전분기비 반등"낸드 5~10% 추가 감산 결정…"재고 조기 정상화 기대"  
  
  
  
 \*재판매 및 DB 금지[서울=뉴시스]이현주 이인준 기자 = SK하이닉스가 올해 상반기만 6조원 이상의 영업손실을 기록했지만, 시장 전망을 웃도는 실적을 거두며 하반기 실적 개선 기대감을 높였다.특히 인공지능(AI) 관련 메모리 수요가 크게 늘면서 DDR5와 HBM(고대역폭메모리) 제품의 출하량이 전분기 대비 2배 이상 급성장하고, 재고도 감소세로 돌아섰다. SK하이닉스는 낸드 플래시 재고 정상화 시기를 앞당기기 위해 5~10% 정도 추가 감산에 나서기로 했다.2분기 매출 7.3조·영업손실 2.8조…3분기 연속 적자SK하이닉스는 26일 실적발표회를 열고, 올해 2분기 매출 7조3059억원, 영업손실 2조8821억원의 경영실적을 기록했다고 밝혔다.매출은 전년 13조8110억원 대비 47.1% 줄었고, 영업이익은 같은 기간 4조1972억원 대비 적자 전환했다. 이에 SK하이닉스는 올해 1분기(3조4023억원 적자)에 이어 상반기만 6조2844억원의 적자를 쌓았다.다만 SK하이닉스는 2분기 증권가 실적 추정치(매출 6조2663억원, 영업손실 2조8943억원)를 웃도는 실적을 냈다. 매출은 1조원가량 웃돌았고, 영업이익은 추정치에 부합했다.또 전분기와 비교하면 매출이 43.6% 커지고, 영업손실은 15.3% 감소했다.영업손실율도 1분기 67%에서 2분기 39%로 낮아졌다. 2분기 순손실은 2조9879억원으로, 1분기(2조5855억원) 대비 소폭 확대됐다.회사는 전분기 대비 실적 개선 배경으로 "챗GPT를 중심으로 한 생성형 AI(인공지능) 시장이 확대되면서 AI 서버용 메모리 수요가 급증했으며, 이에 따라 HBM3와 DDR5 등 프리미엄 제품 판매가 늘어났다"고 밝혔다. 또 전사적인 비용 절감 노력을 지속하는 가운데 재고평가손실이 감소하면서 영업손실폭을 줄일 수 있었다고 설명했다.HBM·DDR5, 2배 이상 성장…차세대 준비중SK하이닉스 관계자는 실적 발표 직후 열린 콘퍼런스콜을 통해 "HBM과 고용량 DDR5 모듈, 두 제품의 매출은 작년 대비 2배 이상 성장할 것으로 보인다"며 "상반기보다 하반기 좀 더 늘어나는 모습이고, 연간 전체적으로 두 제품군의 매출 비중이 20%를 넘어설 것으로 기대하고 있다"고 말했다. 또 "2026년께부터 (차세대) HBM4로 넘어갈 것으로 보고, 거기에 맞춰서 착실하게 준비 중"이라 덧붙였다. 김우현 SK하이닉스 부사장(CFO)은 이날 "메모리 반도체 시장은 1분기를 저점으로 이제 회복 국면에 접어드는 것으로 보인다"고 밝혔다.SK하이닉스에 따르면 2분기에 D램과 낸드 판매량이 모두 늘었다. 특히 D램의 평균판매가격(ASP)이 전분기 대비 상승하며 매출 증가에 큰 영향을 미쳤다. AI 서버에 들어가는 높은 가격의 고사양 제품 판매가 늘어 D램 전체 ASP가 1분기보다 높아졌다.회사 측에 따르면 올해 6월 말 기준 재고자산은 16조4200억원으로, 전분기 17조1820억원 대비 7620억원(4.6%) 감소했다. SK하이닉스가 밝힌 올해 2분기 재고평가환산손실은 5000억원 수준으로, 올해 1분기 1조원 수준 대비 절반 수준으로 줄었다.다만 PC, 스마트폰 시장이 약세를 이어가며 DDR4 등 일반 D램 가격은 하락세를 이어갔다고 밝혔다. 또 SK하이닉스는 D램에 비해 낸드의 재고 감소 속도가 더디다고 보고, 낸드 제품의 감산 규모를 확대하기로 했다. SK하이닉스는 지난해 4분기(10~12월)부터 레거시(구형) 및 저수익 제품 위주로 감산을 진행 중인 가운데, 낸드의 경우 추가로 5~10% 더 줄이기로 했다.회사 측은 "낸드는 AI(인공지능)형 서버 수요 확대에 대한 영향이 D램 대비 제한적이고, 여전히 업계 재고 수준이 높아서 어려운 상황이 지속되고 있다"며 "감산 규모를 확대해서 재고 정상화 시기를 앞당기려고 한다"고 설명했다. 전사 투자를 전년 대비 50% 이상 축소한다는 기조도 변함 없이 이어간다.하반기 AI 수요 강세 지속…실적 개선 속도 높인다SK하이닉스는 올해 하반기 메모리 업황 전망에 대해 AI 메모리 수요 강세가 지속되고, 메모리 기업들의 감산 효과도 뚜렷해질 것으로 진단했다.이에 따라 SK하이닉스는 앞으로도 AI용 메모리인 HBM3, 고성능 D램인 DDR5, LPDDR5와 176단 낸드 기반 SSD를 중심으로 판매를 꾸준히 늘려 하반기 실적 개선 속도를 높이겠다고 밝혔다.또 회사는 올해 10나노급 5세대(1b) D램과 238단 낸드의 초기 양산 수율과 품질을 향상시켜 다가올 업턴(Upturn) 때 양산 비중을 빠르게 늘리겠다고 강조했다.김 부사장은 "그동안 경영 효율화를 통해 확보한 재원으로 향후 시장 성장을 주도할 고용량 DDR5와 HBM3의 생산능력을 확대하기 위한 투자는 지속하겠다"며 "당사는 고성능 제품 기술경쟁력을 바탕으로 빠르게 실적을 개선하도록 노력할 것"이라고 밝혔다．

SK하이닉스, 상반기 적자 6.3조 냈지만…"고부가제품 기대감↑"(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014091535?sid=101

2분기 영업손실 2.9조…'작년 반토막' 매출, 1분기보다는 44% 증가HBM3·DDR5 판매 늘려 실적 개선 속도…낸드 감산 규모는 확대(서울=연합뉴스) 장하나 기자 = SK하이닉스가 글로벌 경기 침체에 따른 메모리 반도체 업황 부진으로 올해 2분기에도 3조원에 가까운 손실을 냈다. 상반기 적자 규모만 6조3천억원에 달한다. 다만 하반기부터 감산 효과가 본격화하고, DDR5와 고대역폭 메모리(HBM) 등 고부가가치 제품 수요가 늘면서 실적이 개선될 것이라는 기대감이 커지고 있다.  
  
  
  
SK하이닉스 이천 본사[연합뉴스 자료사진]SK하이닉스는 연결 기준 올해 2분기 영업손실이 2조8천821억원으로 지난해 동기(영업이익 4조1천972억원)와 비교해 적자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 26일 공시했다. 이번 영업손실은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 2조6천250억원을 9.8% 상회했다. 매출은 7조3천59억원으로 작년 동기 대비 47.1% 감소했다. 순손실은 2조9천879억원으로 적자로 돌아섰다. SK하이닉스는 앞서 1분기에는 3조4천23억원의 영업손실을 냈다. 작년 4분기 1조7천12억원의 영업손실을 내며 2012년 3분기(-240억원) 이후 10년 만에 처음으로 분기 적자를 낸 데 이어 3개 분기 연속 적자를 기록한 셈이다. 앞서 지난 7일 잠정실적을 발표한 삼성전자도 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 6천억원에 그쳐 반도체 부문에서만 3조∼4조원의 영업손실을 냈을 것으로 예상된다. 양사의 반도체 적자 규모만 5조∼6조원대인 셈이다. 다만 1분기와 비교하면 SK하이닉스의 매출은 늘고 영업손실 규모는 줄었다. SK하이닉스는 "챗GPT를 중심으로 한 생성형 인공지능(AI) 시장이 확대되면서 AI 서버용 메모리 수요가 급증했다"며 "이에 따라 HBM3와 DDR5 등 프리미엄 제품 판매가 늘어나 2분기 매출은 1분기 대비 44% 늘고 영업손실은 15% 감소했다"고 설명했다.  
  
  
  
SK하이닉스 1b DDR5 서버용 64기가바이트 D램 모듈, 1b DDR5 16기가비트 단품[SK하이닉스 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.krSK하이닉스에 따르면 2분기에는 D램과 낸드 판매량이 늘었고, 특히 D램의 평균판매단가(ASP)가 1분기 대비 상승한 것이 매출 증가에 영향을 미쳤다. PC와 스마트폰 시장이 약세를 이어가며 DDR4 등 일반 D램 가격은 하락세를 이어갔으나, AI 서버에 들어가는 높은 가격의 고사양 제품 판매가 늘어 D램 전체 ASP가 1분기보다 높아진 것이다. 전사적인 비용 절감 노력 속에 재고평가손실이 감소하면서 영업손실률은 1분기 67%에서 2분기 39%로 줄었다. SK하이닉스는 이날 실적발표회에서 최근 메모리 업황에 대해 AI 메모리 수요 강세가 하반기에도 지속되고 메모리 기업들의 감산 효과도 뚜렷해질 것으로 진단했다. 실제로 AI 서버 수요 확대와 엔비디아의 HBM 채용 확대 계획 등으로 SK하이닉스의 DDR5와 HBM에 대한 기대감이 커지고 있다. SK하이닉스는 HBM 4세대 제품인 HBM3를 2021년 세계 최초로 개발했으며, 지난 4월에는 세계 최초로 D램 단품 칩 12개를 수직 적층해 현존 최고 용량인 24기가바이트(GB)를 구현한 HBM3 신제품을 개발하는 데 성공했다. 내년 상반기에는 5세대 제품인 HBM3E 양산에 돌입하고, 2026년 6세대 제품인 HBM4를 양산할 계획이다. 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 HBM 시장은 2025년까지 연평균 45% 성장할 것으로 전망된다.  
  
  
  
SK하이닉스 HBM3 24GB[SK하이닉스 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr이에 따라 SK하이닉스는 HBM3와 DDR5, LPDDR5, 176단 낸드 기반 SSD를 중심으로 판매를 꾸준히 늘려 하반기 실적 개선 속도를 높이겠다는 계획이다. SK하이닉스는 올해 10나노급 5세대(1b) D램과 238단 낸드의 초기 양산 수율과 품질을 향상시켜 다가올 업턴(상승 국면) 때 양산 비중을 빠르게 늘리겠다고 밝혔다. 대신 D램에 비해 낸드의 재고 감소 속도가 더디다고 보고, 낸드 제품의 감산 규모를 확대하기로 했다. 김우현 SK하이닉스 최고재무책임자(CFO) 부사장은 "전사 투자를 전년 대비 50% 이상 축소한다는 기조에는 변함없지만, 그동안 경영 효율화를 통해 확보한 재원으로 향후 시장 성장을 주도할 고용량 DDR5와 HBM3의 생산능력을 확대하기 위한 투자는 지속하겠다"고 말했다. 김 부사장은 이어 "메모리 반도체 시장은 1분기를 저점으로 이제 회복 국면에 접어드는 것으로 보인다"며 "고성능 제품 기술경쟁력을 바탕으로 빠르게 실적을 개선하도록 노력하겠다"고 강조했다.  
  
  
  
[그래픽] SK하이닉스 실적 추이(서울=연합뉴스) 김민지 기자 = minfo@yna.co.kr 트위터 @yonhap\_graphics 페이스북 tuney.kr/LeYN1 hanajjang@yna.co.kr

삼전·하이닉스 빼면 일본 수준…인건비 부담에 '비명' [강진규의 데이터너머]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004874408?sid=101

미국에 역전된 제조업 이익률  
  
  
  
서울 삼성전자 서초사옥으로 직원 및 방문객들이 드나들고 있다. 사진=뉴스1한국의 제조업 이익률이 정체되면서 미국에 역전을 허용한 데 이어 격차가 더 벌어지고 있는 것으로 나타났다. 삼성전자와 SK하이닉스 등을 제외하면 장기저성장 국면인 일본 수준에 그친다. 1960년대 이후 경제 발전 과정에서 나타났던 높은 수익성과 성장성이 크게 하락한 반면 기업 안정성은 커진 것으로 분석됐다.기업 이익률, 삼전·하이닉스 빼면 일본 수준조윤제 한국은행 금융통화위원과 최연교 통화정책국 통화신용연구팀 과장은 31일 BOK경제연구 '지난 60년 경제환경변화와 한국기업 재무지표 변화' 보고서를 통해 이같은 분석 결과를 내놨다. 이는 한은이 지난 1962년부터 매년 발표하고 있는 '기업경영분석 보고서' 60년치를 정리해 한국 기업 재무성과의 시기별 변화를 포착한 것이다.한국 제조업 기업의 매출액영업이익률은 1960~1979년 9.6%에서 1980~1997년 7.3%, 1998~2021년 6.0% 등으로 하락했다. 대부분 기간에 일본기업들보다는 높고, 미국과 대만기업과는 비슷한 수준을 보여왔다.  
  
  
  
하지만 지난 2021년 기준 한국 제조업 기업의 매출액영업이익률은 6.8%로 10.0%를 기록한 미국보다 3.2%포인트 낮다. 한국 제조업 기업의 이익률은 2009년 5.8%로, 5.6%의 미국을 앞섰지만 2010년 역전을 허용한 후 격차가 벌어지고 있다. 이는 미국의 구글, 마이크로소프트, 애플 등 세계적 독과점 기업의 이익률이 반영된 결과라는 해석이 많다.한국의 경우 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 기업의 성과에 의존하는 모습이 나타났다. 삼성전자와 SK하이닉스의 매출액영업이익률은 2021년 18.3%로, 전체 제조업 기업 이익률(6.8%)의 세배에 이른다. 두 기업을 제외한 제조업 기업의 이익률은 5.3%로, 일본 제조업 이익률(5.2%) 수준에 그친다.올해 삼성전자 이익이 급감하고, SK하이닉스가 영업적자를 기록한 것을 감안하면 제조업 이익률이 최근 더 하락했을 가능성도 제기된다. 관치금융이 주도한 제조업 성장지난 60년간 제조업 기업의 매출액 증가율은 18.9%로 한국의 명목 국내총생산(GDP) 증가율 16.5%를 상회했다. 제조업 기업의 매출 증가가 한국의 경제성장을 이끈 것이다. 제조업 급성장은 1960~1970년에 시작됐다. 국가 주도로 수출과 중화학공업 육성이 본격화된 시기다. 이 과정에서 정부와 한은은 '관치금융'을 통해 기업에 자금을 공급했다. 한은이 직접 발권력을 동원해 정부투자사업을 지원하고, 시중은행장을 은행감독원이 임명하는 방식이었다.그 결과 기업의 부채비율은 급속히 늘었지만 정부가 위험동반자로 나섰기 때문에 도산의 위험 없는 고성장이 가능했다.하지만 이같은 기업구조는 외부충격에 근본적으로 취약했다. 개방과 자유화 등이 본격화된 1990년대 더이상 버티지 못하고 1997년말 외환위기가 찾아왔다. 국제통화기금(IMF)은 글로벌 스탠다드에 맞는 기업경영을 요구했고, 금융시장은 완전히 대외에 개방됐다. 정부의 관치금융이 작동하기 어려워진 상황에서 기업도 부채비율 등 안정성 지표를 관리하는 방향으로 전환했다. 이 과정에서 수익성과 성장성은 크게 낮아졌다. 인건비부담 금융비용의 10배…"독보적 기술혁신 필요"  
  
  
  
최근 기업 수익성에 부담요인으로 떠오른 것은 인건비다. 1971년만해도 매출액 대비 금융비용과 인건비 비중은 각각 9.2%, 10% 정도로 비슷했다. 하지만 2021년 금융비용은 0.7%까지 줄어든 반면 인건비는 11% 선으로 비중이 유지됐다. 금융비용보다 인건비가 10배 이상 더 든다는 의미다. 저자들도 "기업의 수익성을 결정하는데 있어 인건비가 금융비용보다 훨씬 중요한 요인이 됐다"고 설명했다.이같은 기업 수익성 악화 흐름은 비용절감만으로는 반전되기 어려울 것으로 전망됐다. 반도체 기업과 자동차 기업 등 글로벌 시장에서 독보적 기술을 확보할 수 있는 기술혁신과 개발이 필요하다는 것이다. 또 중소기업의 과도한 차입금 의존도, 부채비율 등이 지속되는 것에 대해서도 주의를 기울여야한다고 덧붙였다.

SK하이닉스, 2분기 영업손실 2조8821억

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003778018?sid=105

반도체 불황에 3분기 연속 적자  
  
  
  
경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습./뉴스1 SK하이닉스가 반도체 업황 부진으로 3분기 연속 영업손실을 기록했다.SK하이닉스는 26일 “올해 2분기 매출 7조 3059억 원, 영업손실 2조 8821억 원(영업손실률 39%), 순손실 2조 9879억 원의 경영실적을 기록했다”고 밝혔다.SK하이닉스는 감산을 하며 3조4000억원 수준의 영업손실을 기록한 1분기보다 적자 폭을 줄이긴 했지만 2분기까지 합치면 상반기 적자는 6조원이 넘는다. 반도체 수요 감소가 계속되며 글로벌 D램 가격이 회복하지 못 하고 있는데다낸드 플래시 가격도 부진한 영향이 크다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 지난 6월 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb)의 평균 고정거래가격은 1.36달러에 그쳤다. 지난 2021년 9월(4.1달러) 이후 66.8%나 하락했다. 메모리카드·USB향 낸드플래시 범용제품(128Gb)의 6월 고정거래가도 평균 3.82달러다.다만 시장에서는 반도체 침체 속에서도 회복 조짐이 나타나고 있어 2분기에 바닥을 찍고 하반기로 갈수록 실적이 회복될 것이라는 전망이 나오고 있다. SK하이닉스는 “앞으로 AI용 메모리인 HBM3, 고성능 D램인 DDR5, LPDDR5와 176단 낸드 기반 SSD를 중심으로 판매를 꾸준히 늘려 하반기 실적 개선 속도를 높이겠다”고 밝혔다.

[투자노트] SK하이닉스 끌어올리는 HBM, 수혜주 찾기

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000920285?sid=101

SK하이닉스 주가가 반등하고 있다. 반도체 불황은 여전하지만, 지난 26일 열린 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 SK하이닉스가 줄곧 자신감을 내보였기 때문이다. SK하이닉스 자신감의 원천은 HBM(고대역폭 메모리)이다. 현존하는 최고 사양 HBM을 전 세계에서 유일하게 양산하는만큼, SK하이닉스는 인공지능(AI) 열풍의 주역이 되겠다는 야심에 가득 차 있다.  
  
  
  
지난 26일 오전 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습./연합뉴스 HBM은 대량의 데이터를 한 번에 처리할 수 있는 초고성능·초고용량 메모리다. 원래 그래픽 작업 처리를 위해 만들어졌지만, 최근에는 생성형 인공지능(AI)의 핵심 요소로 자리 잡았다. 챗GPT 등 생성형 AI는 엄청난 양의 데이터를 끊임없이 학습해야 하는데, HBM의 성능에 따라 이 AI에 데이터를 공급하는 속도가 달라진다.D램 여러 개를 쌓아 만드는 HBM은 전력 효율이 높아 데이터전력 소모량을 낮출 수 있고, 물리적인 면적도 축소할 수 있다. 가격은 일반적인 D램 가격보다 훨씬 비싸지만, 데이터 처리 효율을 높이는 데 사실상 유일한 대안으로 꼽힌다. 업계에 따르면 HBM 시장은 용량 기준으로 2024년까지 2배 이상, 금액 기준으로는 2028년까지 3배 이상(약 60억달러) 성장할 전망이다.글로벌 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 2022년 세계 HBM생산 시장 1위는 SK하이닉스로, 점유율 50%를 차지했다. 삼성전자(40%), 미국 마이크론(10%)이 뒤를 이었다. 이들 기업은 HBM을 생산해 미국 엔비디아 등에 공급한다. 대표 HBM 관련주로 엔비디아와 SK하이닉스가 꼽히는 이유다.발 빠른 투자자들은 숨겨진 HBM 관련주 찾기에 나서고 있다. 하지만 HBM이 높은 수준의 기술력이 있어야 하는 만큼, 옥석 가리기도 필요하다. 국내 종목 중에는 한미반도체가 투자자들의 관심을 끌고 있다. 한미반도체는 여러 반도체 칩을 정밀하게 쌓아 올리는 장비를 보유하고 있다.해외 종목 중에서는 미국 램리서치(LRCX)가 주목받고 있다. 메모리 전공정 중 식각 분야에서 시장 점유율 50% 이상을 차지하고 있는 장비 업체다. 식각 공정은 웨이퍼에 미세한 회로 패턴을 조각하는 과정이다. 미국 어플라이드머티리얼즈(AMAT)는 통신 속도를 향상시키면서 신호 손실을 줄여 반도체를 쌓는 기술 개발에 주력하고 있다.일본 기업 디스코도 있다. HBM이 D램 여러 개를 쌓아 만드는 만큼, 이를 얇게 만들어 물리적으로 차지하는 공간을 줄여야 하는데 여기에 특화된 기업이다. 일본 어드반테스트는 만들어진 반도체 성능을 검증하는 테스트 장비를 제조하는 회사다.삼성증권은 “엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 만들기까지 필요한 반도체 후공정(패키지) 기술이 중요해지면서, 각 기업이 후공정 투자를 늘리며 관련 산업이 재조명받고 있다”면서 “올해 증시가 급등하며 관련 기업의 주가가 크게 상승했지만, 성장성을 감안하면 중장기 관점에서 여전히 매력적”이라고 평가했다.